

产品概要

雅拓莱免洗无铅锡膏

产品名称

#502 –无铅锡膏 – Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5

产品编号

EMCO#502-307P

在此宣传册里的信息和声明均是可信的，但我公司不承担任何担保和陈述上的责任。为确保这里的任何信息和产品对各自目的的适用性，用户需要做出充分的认证和测试来测定。没有任何针对特别目的的适合性可以担保。所运用所有产品特性都是象征性的，不可以作为规格使用

DOC CATEGORY: 3

PF – EMCO#502-307P – 04122014 – REV.C – Chinese – Page 1 of 5



. China . Malaysia . Singapore

产品描述

雅拓莱的 EMCO#502-307P 免洗焊膏是专为无铅焊接所应用. 它使用高抗剪切阻力的成分, 并提供出色的印刷能力。这种助焊剂能承受较高的预热温度并且不变色。EMCO#502-307P 是专为高速印刷操作而制造。EMCO#502-307P 提供优异的润湿和焊接在大多数电路板成包括 OSPs, 减少锡球的形成和锡珠.

特征:

- 卓越的印刷功能 - 适用于超细间距焊接操作
- 宽松回流- 增加生产的工艺
- 减少锡珠 - 最大限度地减少返工
- 防焊接面配方 - 符合 IPC 7095 Voids Performance 分级 III 级

CHEMICAL COMPOSITION OF ALLOY

雅拓莱的 EMCO#502-307P 无铅锡线的成份被严格控制在以下 LF-307 规格: -

Elements		Specification (%wt/wt)
锡	Sn	Remainder
铅	Pb	Max 0.050
铝	Al	Max 0.005
锑	Sb	Max 0.050
砷	As	Max 0.030
铋	Bi	Max 0.050
铜	Cu	0.4 – 0.6
铁	Fe	Max 0.010
锌	Zn	Max 0.003
镉	Cd	Max 0.002
银	Ag	2.8 – 3.2
镍	Ni	Max 0.010
铟	In	Max 0.050
金	Au	Max 0.050

在此宣传册里的信息和声明均是可信的, 但我公司不承担任何担保和陈述上的责任。为确保这里的任何信息和产品对各自目的的适用性, 用户需要做出充分的认证和测试来测定。没有任何针对特别目的适合性可以担保。所运用所有产品特性都是象征性的, 不可以作为规格使用

产品外观

雅拓莱的锡膏呈现为灰色的均匀的锡膏。

锡粉颗粒

焊料颗粒的大小依据国际标准规格 IPC J-STD-005。

按样品中重量百分比%	标称尺寸 3	标称尺寸 4
少于 1%的样品尺寸大于	45 微米	38 微米
最少 80%的样品介于	45-25 微米	38-20 微米
最多 10%的样品小于	20 微米	20 微米

EMCO#502-307P 无铅锡膏特性

检测项目	特性	检测方法
粘度	120,000 ± 30,000 cp	PCU-203, 10rpm, 25°C
助焊剂活性	ROL0	IPC J-STD-004
铜板腐蚀试验	Pass	IPC J-STD-004
助焊剂含量	11.5 ± 0.5%	JIS Z 3197
扩散试验	Pass	IPC J-STD-005
锡珠试验	Pass	IPC J-STD-005
坍塌试验	Pass (10 min at 150°C)	IPC J-STD-005
表面绝缘阻抗(典型的), 168 小时 @85°C/85%RH (Ω)	Pass (≥1 x 10 ⁹ Ω)	IPC J-STD-004

在此宣传册里的信息和声明均是可信的，但我公司不承担任何担保和陈述上的责任。为确保这里的任何信息和产品对各自目的的适用性，用户需要做出充分的认证和测试来测定。没有任何针对特别目的的适合性可以担保。所运用所有产品特性都是象征性的，不可以作为规格使用

检测项目和结果

印刷

模板材料
模板的厚度

不锈钢
周节
0.3-0.5 毫米
0.635 毫米

模板的厚度
0.100-0.150 毫米
0.150-0.200 毫米

刮刀
刮刀压力

建议使用不锈钢刮刀。
0.16-0.34 公斤/平方厘米刮刀长度取决于印刷速度。较高的印刷速度需要较高的刮刀压力。

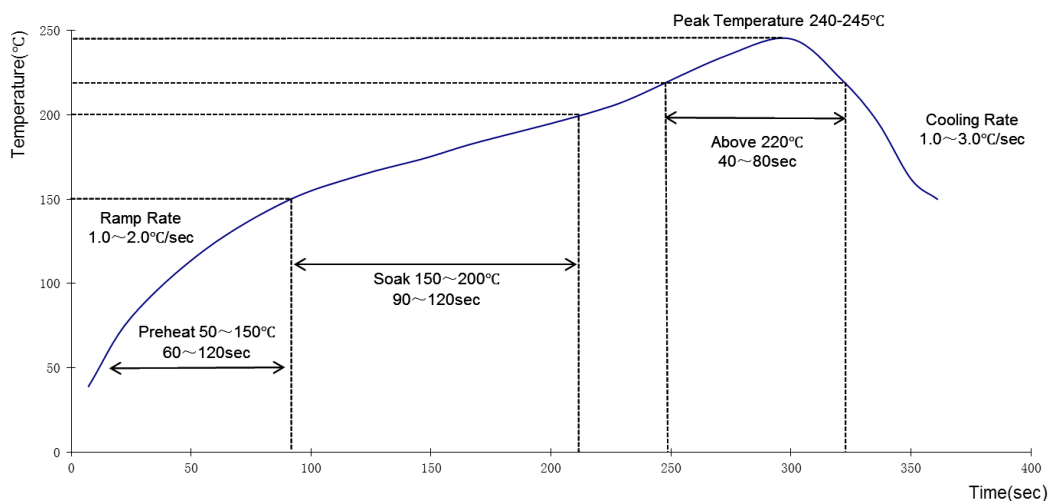
刮刀速度

25-100 毫米/秒

贴辊

保持贴辊直径为 15-20 毫米。

EMCO#502-307P 的回流曲线



预热

以 1-2°C/s 的速度从室温加热到 140-150°C。更快的速度会因蒸发吸附的湿气而造成元件的破裂。

在此宣传册里的信息和声明均是可信的，但我公司不承担任何担保和陈述上的责任。为确保这里的任何信息和产品对各自目的的适用性，用户需要做出充分的认证和测试来测定。没有任何针对特别目的的适合性可以担保。所运用所有产品特性都是象征性的，不可以作为规格使用

均热处理区

介于 150 和 200°C. 均热处理区用于使 PCB 板上的温度差异变水平。经常用于红外线炉与元件和铜料分布带有较大差异的 PCB 板。

提速至回流

最大 2°C/s, 因为元件内部不同的热膨胀率。

回流

峰值温度与元件规格有关。在 5-8 秒时峰值温度介于 240-245°C, 40-80 秒高于 220°C。

冷却

最大 3°C/s, 因为元件内部不同的热膨胀率。

清洗

印刷错误 可用与市售的溶剂清洁剂擦拭

清洗 EMCO#502-307P 回流焊接后留在电路板上的残渣, 如果需要清洗, 可使用市售的溶剂清洁剂。

模板清洗 建议使用市售的丝网清洗剂蜡纸擦拭。

包装

每罐锡膏重约 500 克, 应严格密封。标贴上应附有产品编号、合金成份、颗粒尺寸、净重和产品批号等相关信息。锡膏罐应置于泡沫盒内, 且包装在硬纸盒里, 每盒重量约为 10 公斤。可要求 600 或 1000 克的卡头式型锡膏。

贮存和保质期

请存放在 3-10°C 以下。锡膏有效期限自生产日期开始六个月内。锡膏使用之前, 需要回温大约 4 小时后才能使用。在把锡膏放到模板前, 可用匙搅拌锡膏为 1-2 分钟或锡膏搅拌机为 30-60 秒。

出货

出货同时附上分析证明书。

材料安全数据单

产品的 MSDS/ SDS 可向销售部索取。

在此宣传册里的信息和声明均是可信的, 但我公司不承担任何担保和陈述上的责任。为确保这里的任何信息和产品对各自目的的适用性, 用户需要做出充分的认证和测试来测定。没有任何针对特别目的的适合性可以担保。所运用所有产品特性都是象征性的, 不可以作为规格使用